

有机硅灌封胶 EncapSil 1400

产品序列号 S101

一、产品概述

有机硅灌封胶 EncapSil 1400 S101 是一种双组份室温/加热加成型有机硅灌封胶,适用于电子电器产品的灌封防护,可延长电子产品的使用寿命。使用时,按照 A: B=10: 1 (质量比) 的比例混合均匀,经过一定时间后,固化成具有良好弹性的防护材料。

二、产品特性

1. 粘度低、流动性好,可浇注到狭窄缝隙中;
2. 固化过程中收缩小,具有更优的防水防潮性能;
3. 加热可快速固化,自排泡性好,操作使用方便;
4. 绝缘性优异,抗老化性能好,可在-40~200°C 内长期保持橡胶弹性;
5. 氧指数可达 36%以上, UL94 V0, RTI=150°C 档案号: **E502051**;
6. 符合 ROHS/REACH。

三、性能指标

序号	测试项目	单位	参考标准/条件	测试结果
1.	A 组分外观	——	目测	灰色均匀无杂质
2.	B 组分外观	——		无色透明无杂质
3.	A 组分粘度	mPa s	GB/T 10247	10000-15000
4.	B 组分粘度	mPa s		60-100
5.	A、B 混合粘度	mPa s		1000-8000
6.	A、B 混合比例 (质量比)	——	——	10:1
7.	表干时间	min	25°C	20-60
8.	密度	g/cm ³	HG/T 2728	1.55-1.70
9.	硬度 (Shore A)	——	GB/T 531.1	40-50
10.	氧指数	——	GB/T 2406-2009	≥36%
11.	阻燃性能	-	UL-94	V0

注: 1、采用设备型号: BROOKFIELD DV2T LV, 测试条件: 温度 25°C, 转子 63#;

2、操作时间、初固及工艺固化时间: 根据客户实际工艺操作要求可以调整;

3、粘度、密度、硬度等指标因不同厂家的测试设备型号不同而有一定的结果差异。

四、应用领域

广泛应用于精密电子元器件、电子模块、电器模块、照明电器、户外显示屏、光伏逆变器、电源和线路板等的灌封保护。

五、施工方法

- 1、将 A、B 两组分按质量比 10: 1 称量, 然后混合搅拌均匀, 在操作时间内浇注到需灌封的产

- 品上,如灌封产品过大,可采取分多次灌封的方式,然后根据上表所对应的固化条件固化即可;
- 2、胶料放置时间过长会产生沉淀,需在取用前先将 A、B 组分各自搅拌均匀,然后再混合,取用后请将 A/B 组分存放于阴凉处密封保存;
 - 3、搅拌时,应该注意同方向搅拌,否则会混入过多的气泡;容器边框和底部的胶料也应搅拌均匀,否则可能会出现局部不固化现象;
 - 4、灌封到产品上后再次抽真空排泡,可提高产品固化后的综合性能;
 - 5、硫化时间决定于硫化温度及制品厚度,具体硫化时间要根据实际情况调整。

六、注意事项

- 1、将 A 和 B 两组分混合时,配比不准确将会影响硫化过程和制品性能,因此要准确控制混合比例。
- 2、如果胶料接触某些含有氮、硫、磷、锡、铅等化合物的物质时,硫化反应速度将会受到抑制,严重时导致产品不固化,应避免胶体与此类物质的接触。
- 3、对含有不明材料的设备或者器件灌封时,请在灌封前做好必要的胶料固化状态以及固化时间验证工作。

七、包装规格

A: 25 千克/桶; B: 25 千克/桶

八、储存及运输

- 1、B 组分需避光、避热、密封储存(可作为非危险品运输及储存);
- 2、25°C 条件下可储存 6 个月。

九、有限保证信息

此处提供的信息与我们的实践经验一致。然而,由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制,本信息不能取代客户为安全、有效并完全满足于特定的最终用途而进行的测试。我们所提供的建议,不得被视为侵犯任何专利权的导因。本产品资料不能被视为完整的资料,本公司对此不承担任何义务,同时也不对第三方提出的索赔要求负任何义务。